U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2 (1008732)

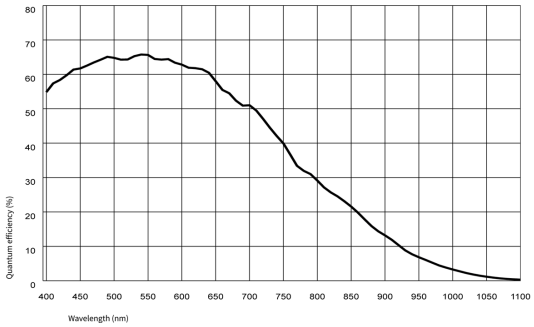
生産終了
このカメラモデルは生産終了となりました。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	2 MP
有効画素数	2.30 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1920 x 1200 ピクセル
アスペクト比	16:10
ADC	10 bit
色深度 (カメラ)	10 bit
光学センサークラス	1/2.6″
撮像面積	5.760 mm x 3.600 mm
光学センサーの対角	6.79 mm 1/2.6″
画素サイズ	3 µm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Onsemi
センサーモデル	AR0234CSSM00SUKA0
ゲイン (マスター/RGB)	15.1x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	48 / 12
AOI 画像の高さ、ステップ幅	4 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	4 / 2
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング)水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング)手法	M/C 自動



T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2 (1008732)

モデル

フレームレートフリーランモード	101 fps
フレームレートトリガー（連続）	100 fps
フレームレートトリガー（最大）	100 fps
露出時間（最小～最大）	0.012 ms – 446 ms
消費電力	0.5 W – 1 W
画像メモリ	–

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C – 55 ° C / 32 ° F – 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C – 80 ° C / -4 ° F – 176 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % – 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB Type-C
I/O コネクター	–
電源	USB ケーブル

設計

レンズマウント	CS- / C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	47.0 mm x 46.0 mm x 23.9 mm
重量	40 g
ハウジング素材	プラスチック

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。
このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	–
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	–
	Long exposure	–
	Line scan	–
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	–
画像調整	Auto exposure	–
	Auto gain	–
	Auto whitebalance	–
	Color correction	–
	Gamma	–
	LUT	–
	Mirror/flip	X/Y

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp

U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2 (1008732)

統合画像処理	Pixel formats	Mono8 Mono10g40IDS
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	–
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	–
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

その他	Chunks	–
	Sequencer	–
	Events	–
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.2

T.E.M. Incorporated
NBC Annex Ichigaya Bldg. 2F, 9-1 Funagawara-machi, Ichigaya, Shinjuku-ku · 162-0826 Tokyo, Japan · Telefon +81 3/5256-2054 · Fax +81 3/5256-2272 · E-Mail ids@tem-inc.co.jp